

2008年1月30日
株式会社日立製作所

エンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において 新世代プロセッサPOWER6 搭載エントリーモデルをラインアップに追加



EP8000 550、520
(POWER6 搭載)

日立製作所（執行役社長：古川 一夫／以下、日立）は、このたび、高性能・高信頼なシステム向けのエンタープライズサーバ「EP8000 シリーズ」において、新世代 POWER6 プロセッサを搭載したエントリーモデル「EP8000 550」、「EP8000 520」を新たにラインアップに追加し、2月1日から販売を開始します。

「EP8000 シリーズ」は、システムとしてメインフレームクラスの信頼性と可用性を備え、ユーザーの基幹業務システムを支えてきました。これまでに、金融機関をはじめ、電力、交通といった社会基盤や企業の基幹業務において多くの採用実績があります。今回発表のモデルにおいても、日立独自の高速系切替機能^(*)などの高信頼化機能を提供するとともに、日立ディスクアレイサブシステムとの連携機能、安定稼働に役立つ情報提供や AIX 予防保守パッチ提供、AIX ソースコード解析による緊急パッチの提供といった高信頼サポートサービスも提供します。

*1 高速系切替機能：サーバに何らかの障害が発生した場合に、すばやく現用系から待機系のサーバに切り替えることを実現する機能

■新モデルの特徴

(1) 従来比、最大約 1.7 倍のトランザクション処理性能を実現

「EP8000 550」は POWER6(4.2/3.5GHz)を最大 8way 構成まで可能なエントリーモデルで、POWER5+を搭載した従来モデル「EP8000 550Q」に比べ、最大約 1.7 倍のトランザクション処理性能を実現しました。メモリは最大 256GB、PCI スロット^(*)は I/O ドロワー^(*)を接続することで最大 59 スロットまで増強できます。これにより、小規模から中規模の業務システム、データベース、オンライントランザクション処理システムなどに対応する、優れた性能と拡張性を実現しています。

「EP8000 520」は POWER6(4.2GHz)を最大 4way 構成まで可能なエントリーモデルです。下位ク

ラスのエントリーモデルながら、メモリは最大 64GB、PCI スロットは I/O ドロワー - を接続することで最大 60 スロットまで増強できるなど、エントリーモデルとして非常に高い拡張性を備えており、プロセッサ性能を重視する小規模の業務システム、データベースなどに最適なモデルです。

*2 PCI スロット:PCI カードを装着する差し込み口

*3 I/O ドロワー :拡張 PCI スロットやディスクドライブスロットなどを内蔵する I/O 拡張機構

(2) メインフレームクラスの信頼性と可用性を実現

「EP8000 シリーズ」では、これまで動的プロセッサ切り離し機能^{(*)4}、PCI バス障害回復機能^{(*)5}など、様々な高信頼化機能をサポートしてきましたが、今回、命令リトライ・リカバリ機能^{(*)6}を新たにサポートし、プロセッサ内部での命令実行中にエラー発生した場合にも処理を止めることなく業務を継続できます。これらの機能により、システム停止につながる障害発生を低減させることができ、メインフレームクラスの信頼性と可用性を実現します。

*4 動的プロセッサ切り離し機能:障害の発生したプロセッサを自動的に切り離して他のプロセッサで処理を継続させる機能

*5 PCI バス障害回復機能:PCI バスや PCI アダプタに障害が発生しても、システムリブートを回避してシステムを継続させる機能

*6 命令リトライ・リカバリ機能:プロセッサの内部状態を常時保持することで、エラー発生時には直前の正しい状態に復元することができ、さらに処理の再開後に障害が続く場合には予備プロセッサに処理を継続させる機能

なお、「EP8000 550」「EP8000 520」POWER6 搭載モデルでは、POWER6 プロセッサの仮想化機能であるライブ・パーティション・モビリティ機能をサポートする予定です。これはサーバが稼働中でもパーティションの移設をサーバ間で行うことができる機能です。これにより、メンテナンスに伴うサーバの計画停止や、システム内での業務負荷に応じたパーティションの再配置を、サービスを止めずに実現でき、システム管理効率やサーバ使用効率の向上を図ることができます。

新製品の概要

モデル	形状	プロセッサ (周波数)	最大プロセッサ数 (way)	メモリ容量
EP8000 550	ラックマウント	POWER6(4.2GHz) POWER6(3.5GHz)	8	4 ~ 256GB
	タワー	POWER6(4.2/3.5GHz)	4	4 ~ 128GB
EP8000 520	ラックマウント /タワー	POWER6(4.2GHz)	4	2 ~ 64GB

*なお、AIX version 6.1 は、2008 年 4 月末以降のサポートとなります。

新製品の価格と出荷時期

モデル	価格	出荷時期
EP8000 550	683万7,600円～ (税抜 651万2,000円～)	4.2GHz : 2008年2月29日 3.5GHz : 2008年4月30日
EP8000 520	166万6,350円～ (税抜 158万7,000円～)	2008年4月30日

他社商標注記

- ・AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- ・POWER5+、POWER6 は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- ・UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- ・その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

製品情報

<http://www.hitachi.co.jp/EP8000/>

取扱事業部・照会先

株式会社 日立製作所 情報・通信グループ
エンタープライズサーバ事業部 企画部[担当:石口]
〒259-1392 神奈川県秦野市堀山下1番地
電話:0463 - 87 - 6786(ダイヤルイン)

以上

■新製品の特徴

1. ラックマウント型とタワー型を用意

「EP8000 550」、「EP8000 520」ともに、筐体はラックマウント型とタワー型の2種類を用意しています。マシンルームからオフィスまで、設置場所を選ばない省スペース設計です。



ラックマウント型
(標準ラック筐体に搭載)



タワー型

2. 最新のソフトウェア環境を提供

オペレーティングシステム(OS)は、POWER6/POWER5+搭載モデルの性能・機能を最大限に引き出す米国 IBM 社の高信頼化機能を実装した UNIX OS「AIX version 6.1」^{(*)1}に対応していきます。

「AIX version 6.1」は、優れたパフォーマンス、信頼性・可用性、Linux との高い親和性に加え、セキュリティや Java 実行環境などネットビジネス構築のためのオープンかつミッションクリティカルな基盤機能も提供します。ミドルウェア/アプリケーションには、基幹業務システムで実績のある日立オープンミドルウェア製品に加え、DBMS^{(*)2}製品 Oracle[®]や SAP[®] R/3[®]を含む E ビジネスプラットフォーム mySAP.com[®]など豊富な ISV^{(*)3}製品が利用でき、幅広いニーズに対応したシステムを構築することが可能です。

*1 2008 年 4 月末以降にサポート予定です

*2 DBMS: Database Management System

*3 ISV: Independent Software Vendor

■他社所有商標に関する表示

- AIX、IBM は、米国における米国 International Business Machines Corp.の登録商標です。
- Java 及びすべての Java 関連の商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc.の商標または登録商標です。
- Linux は、Linus Torvalds の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。
- Oracle は、Oracle Corporation の登録商標です。
- POWER6、POWER5+は、米国における米国 International Business Machines Corp.の商標です。
- SAP[®]、R/3[®]、mySAP.com[®]は、SAP AG のドイツおよびその他の国における登録商標または商標です。
- UNIX は、X/Open Company Limited が独占的にライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。
- その他、記載の会社名、製品名はそれぞれの会社の商標もしくは登録商標です。

■新製品の仕様

モデル		EP8000 550 POWER6搭載モデル			
形状		タワー		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER6			
	クロック・レート (GHz)	3.5	4.2	3.5	4.2
	プロセッサ数 (way)	2/4		2/4/6/8	
レベル2キャッシュ(MB ^{*4})		4 (1wayあたり)			
レベル3キャッシュ(MB ^{*4})		32 (2wayあたり)			
メモリ容量	最小～最大(GB ^{*4})	4～128		4～128	4～256
ディスク容量	最小～最大(GB ^{*5})	146.8～1,800		146.8～63,000 ^{*6}	
拡張PCI スロット本数	CPUドロー	PCI-Express<x8>: 3 PCI-X: 2			
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	-		PCI-X: 6	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	-		PCI-X: 7	
I/Oドロー(ディスクベイ無)		-		0～8	
I/Oドロー(ディスクベイ有)		-		0～8	
外形寸法 (W×D×Hmm)	CPUドロー	-		440×730×175 (4U ^{*7})	
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	-		224×800×172 (4U ^{*7})	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	-		482×610×178 (4U ^{*7})	
	搭載筐体	183×778×540		標準ラック筐体 (23U～42U) ^{*8}	
電源電圧(V)		100～127 (単相)		100～127 ^{*9} /200～240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示 (2007年度規定)	区分	-			
	エネルギー消費効率	対象外			
搭載OS		AIX version 6.1 ^{*10} または AIX version 5.3			

モデル		EP8000 520 POWER6搭載モデル			
形状		タワー		ラックマウント	
プロセッサ	プロセッサ名称	POWER6			
	クロック・レート (GHz)	4.2		4.2	
	プロセッサ数 (way)	1/2/4		1/2/4	
レベル2キャッシュ(MB ^{*4})		4 (1wayあたり)			
レベル3キャッシュ(MB ^{*4})		-			
メモリ容量	最小～最大(GB ^{*4})	2～64			
ディスク容量	最小～最大(GB ^{*5})	146.8～1,800		146.8～63,000 ^{*6}	
拡張PCI スロット本数	CPUドロー	PCI-Express<x8>: 3 PCI-X: 2			
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	-		PCI-X: 6	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	-		PCI-X: 7	
I/Oドロー(ディスクベイ無)		-		0～8	
I/Oドロー(ディスクベイ有)		-		0～8	
外形寸法 (W×D×Hmm)	CPUドロー	-		440×538×173 (4U ^{*7})	
	I/Oドロー(ディスクベイ無)	-		224×800×172 (4U ^{*7})	
	I/Oドロー(ディスクベイ有)	-		482×610×178 (4U ^{*7})	
	搭載筐体	183×628×540		標準ラック筐体 (23U～42U) ^{*8}	
電源電圧(V)		100～127 (単相)		100～127/200～240 (単相)	
省エネ法に 基づく表示 (2007年度規定)	区分	-			
	エネルギー消費効率	対象外			
搭載OS		AIX version 6.1 ^{*10} または AIX version 5.3			

エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。

*4 1MB(メガバイト)=1,024²バイト, 1GB(ギガバイト)=1,024³バイトです。

*5 1GB(ギガバイト)=1,000³バイトです。

*6 I/Oドロー(ディスクベイ有) 8台、ディスクドロー9台接続時。

*7 ラック搭載時の占有サイズ(1U=高さ約44.5mm)。

- *8 ラック筐体は、下記のうちから選択できます。
23U ラック筐体(格納サイズ 23U)外形寸法 647×1,104×1,193 (W×D×H:mm)
36U ラック筐体(格納サイズ 36U)外形寸法 647×1,104×1,804 (W×D×H:mm)
42U ラック筐体(格納サイズ 42U)外形寸法 647×1,104×2,015 (W×D×H:mm)
- *9 2way/3.5GHz、4way/3.5GHz、2way/4.2GHz、4way/4.2GHz のみ。
- *10 AIX version6.1 は、2008 年 4 月末以降のサポートとなります。

以 上

このニュースリリース記載の情報(製品価格、製品仕様、サービスの内容、発売日、お問い合わせ先、URL 等)は、発表日現在の情報です。予告なしに変更され、検索日と情報が異なる可能性もありますので、あらかじめご了承ください。
